

# 聯發科技 2024年第二季法人說明會

## MediaTek 2024-Q2 Investor Conference

July 31, 2024

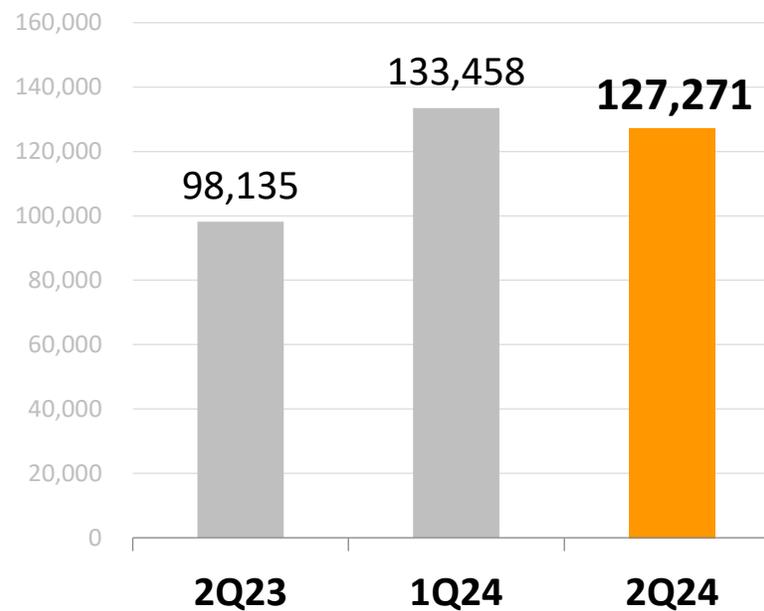
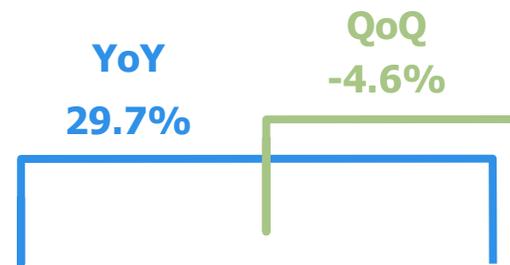
# 投資安全聲明

簡報內所提供之資訊 (除歷史資訊外)屬預測性陳述，受到各種風險及不確定性因素影響，可能造成實際結果與陳述內容發生顯著不符，這些不確定性因素包括：受到競爭性產品及定價之影響、設計是否及時被客戶接受、新技術是否及時導入利用、新產品大量量產之能力、產業及市場對半導體產品之供給及需求移轉、產業及市場是否供給過剩、製造產能可得利用情況、終端市場之財務穩定性、人才留任困難之可能性、無法預期之成本和費用、任何併購相關之不確定性，如主管機關核准之取得或整合延遲、重要客戶之流失、法律或行政訴訟之涉及、可能會影響營運之新法規、外匯匯率之波動、全球經濟因素或非經濟因素之影響及其他風險因素等。

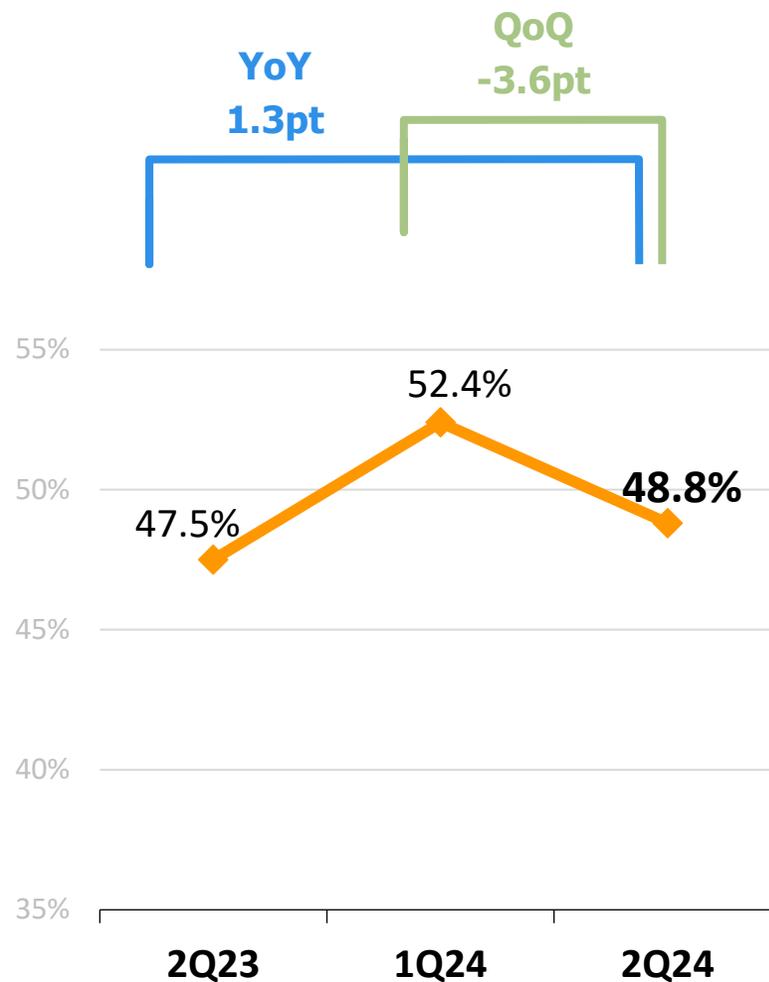
本簡報亦補充非以金管會認可之國際財務報導準則製作之財務資訊(Non-TIFRS)，該資訊並未納入股份基礎給付獎酬、因企業合併產生之資產增值攤銷及所得稅影響數等財務影響之考量。此補充資訊僅供參考而非替代以金管會認可之國際財務報導準則製作之資訊，請注意最終實際盈餘分配將依照國際財務報導準則製作之財務報告分配之。

# 合併營業收入

(單位：新台幣佰萬元)

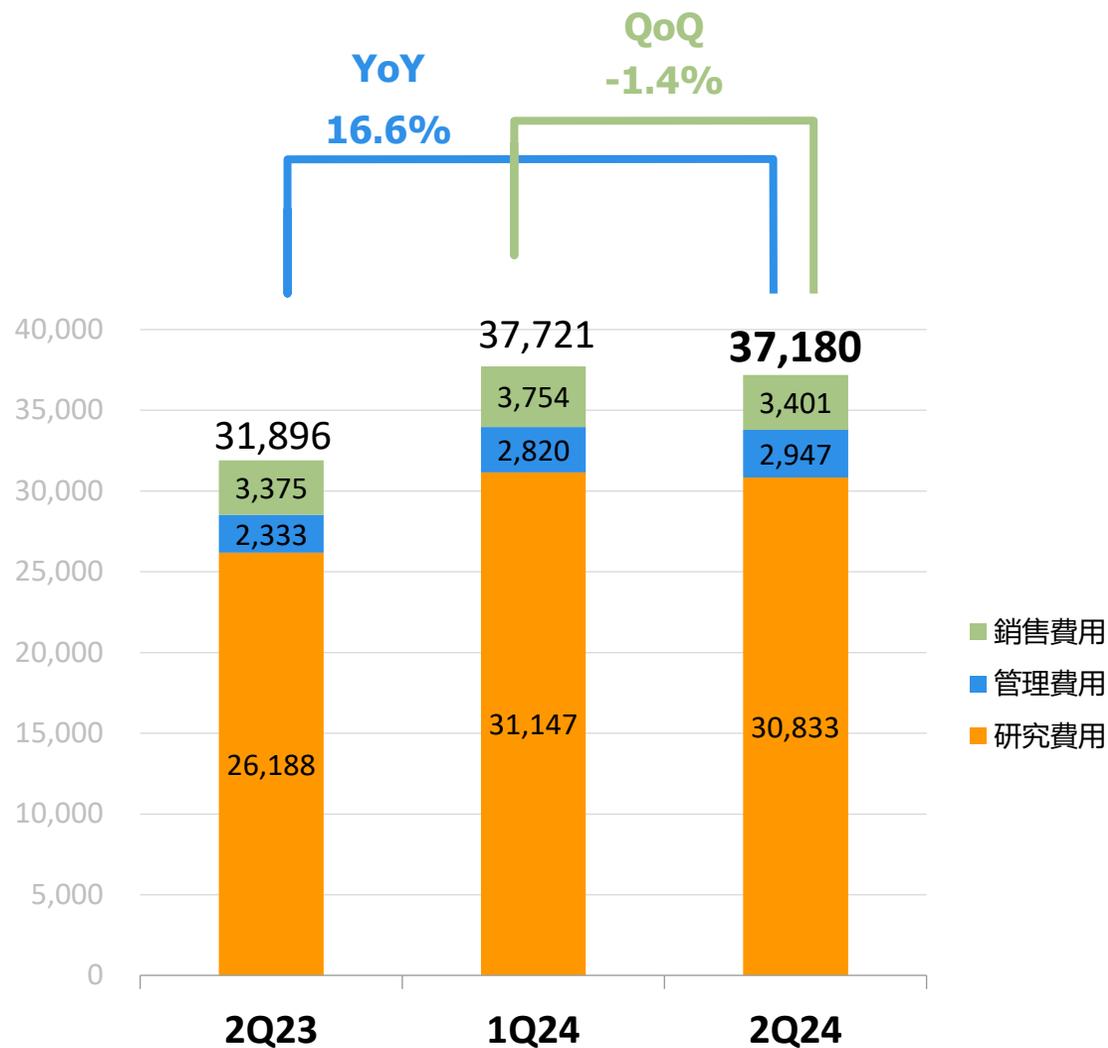


# 合併營業毛利率



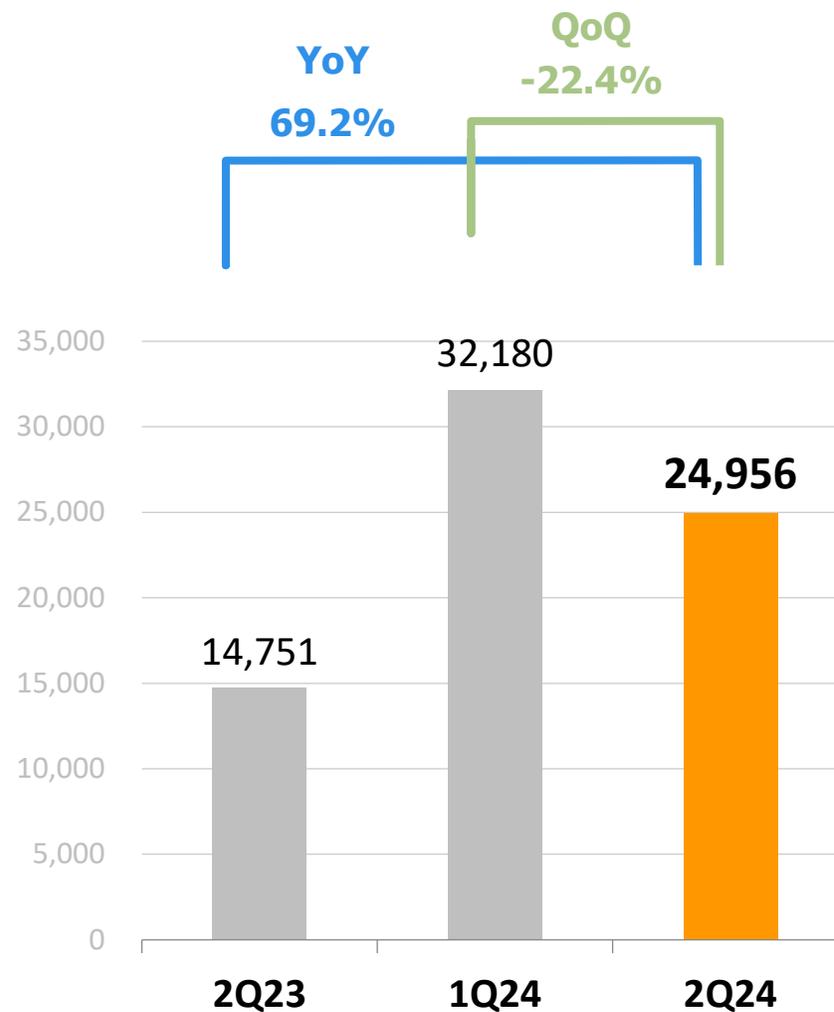
# 合併營業費用

(單位：新台幣佰萬元)

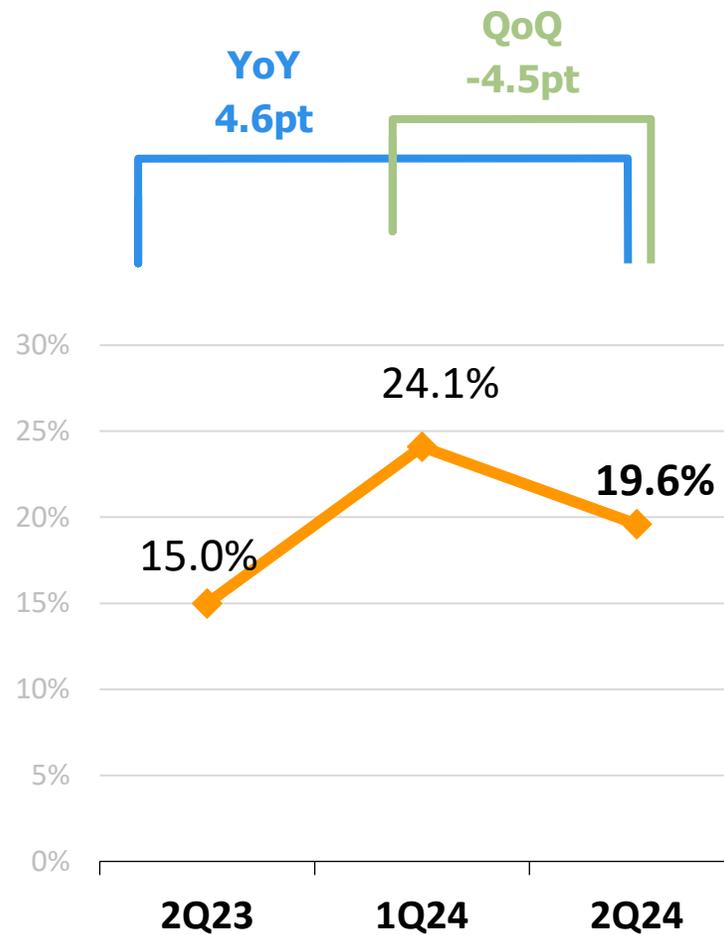


# 合併營業利益

(單位：新台幣佰萬元)

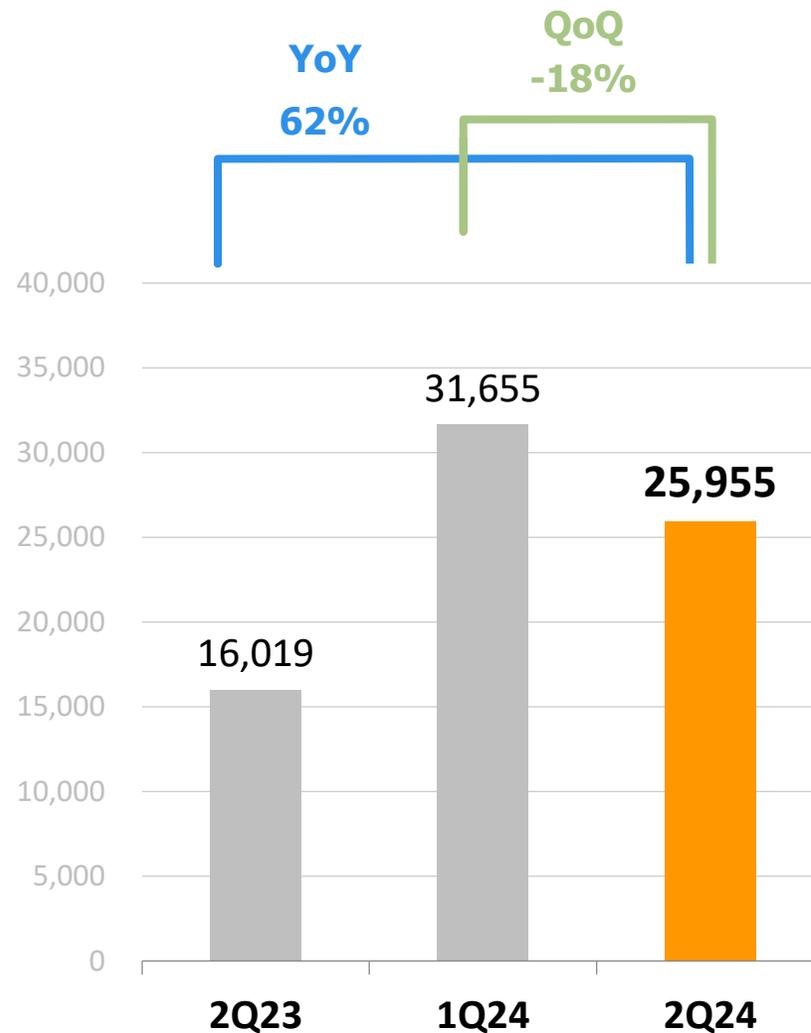


# 合併營業利益率

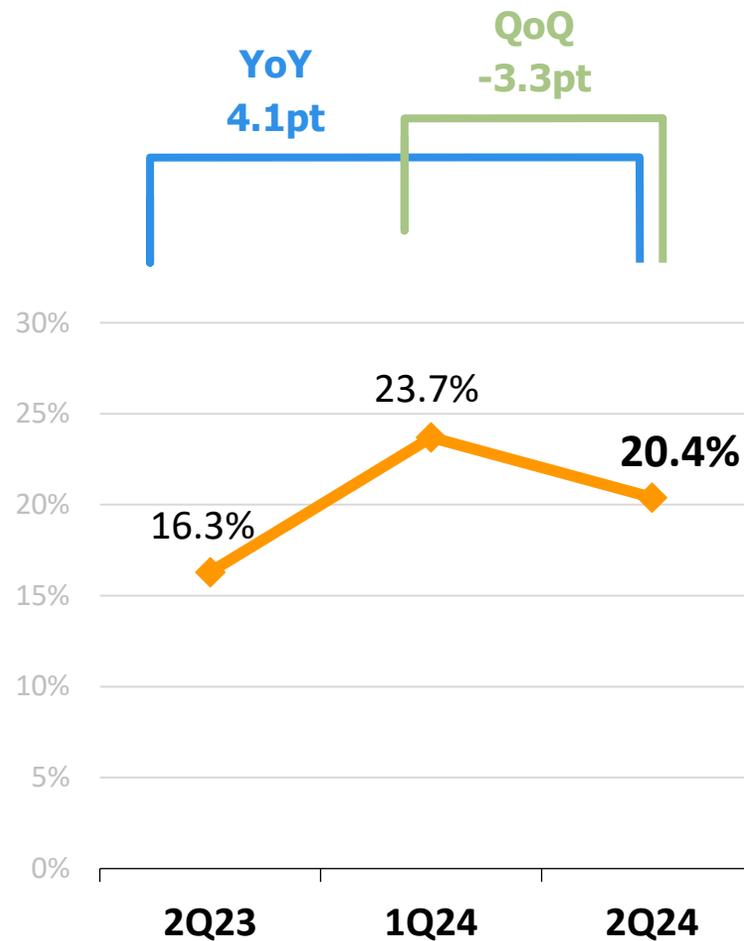


# 合併本期淨利

(單位：新台幣佰萬元)

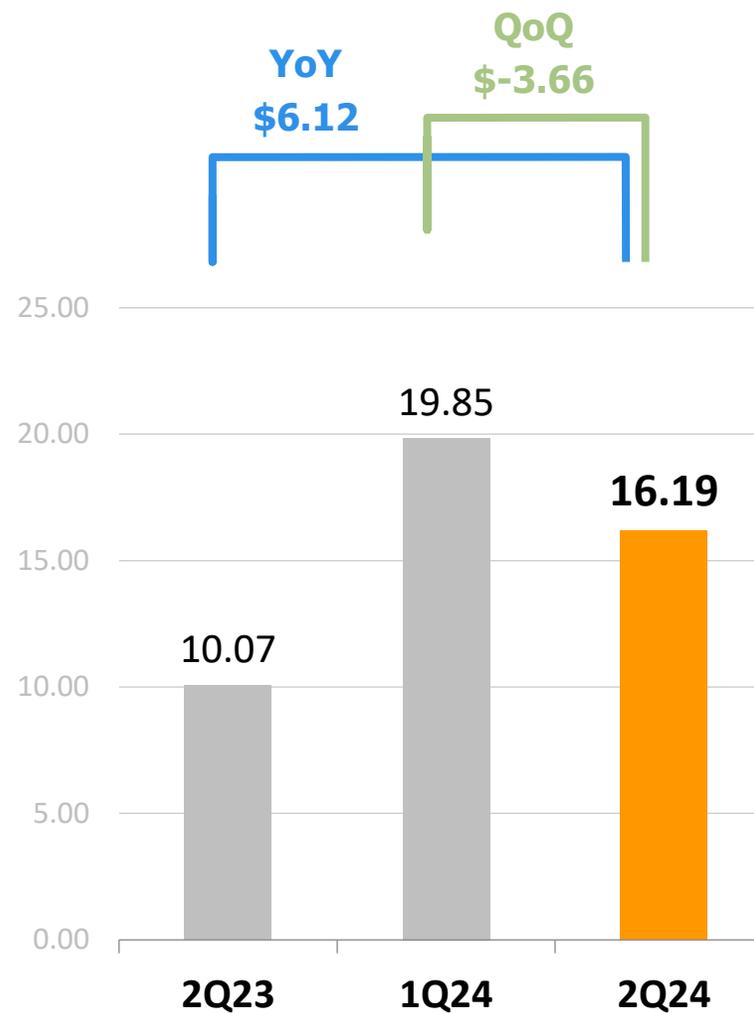


# 合併本期淨利率



# 合併每股盈餘

(單位：新台幣元)



# 2024年 第三季營運展望

- 合併營收：約新台幣 1,235億 ~ 1,324億元  
(假設2024-Q3美元兌新台幣平均匯率為1:32.3)
- 合併毛利率：47% ± 1.5%
- 合併營業費用率：30% ± 2%

(TIFRS)

金管會認可之國際財務報導準則 (TIFRS)  
財務報表

## 聯發科技股份有限公司 合併損益表 (自結數)

(單位:新台幣佰萬元)	2024年 第二季	2024年 第一季	2023年 第二季	Q-Q	Y-Y
營業收入	127,271	133,458	98,135	(4.6%)	29.7%
營業成本	(65,135)	(63,558)	(51,489)		
營業毛利	62,136	69,901	46,646	(11.1%)	33.2%
推銷費用	(3,401)	(3,754)	(3,375)		
管理費用	(2,947)	(2,820)	(2,333)		
研究發展費用	(30,833)	(31,147)	(26,188)		
營業費用合計	(37,180)	(37,721)	(31,896)		
營業利益	24,956	32,180	14,751	(22.4%)	69.2%
營業外收入及支出	4,241	3,490	3,620		
稅前淨利	29,197	35,670	18,370		
所得稅費用	(3,242)	(4,015)	(2,351)		
本期淨利	25,955	31,655	16,019	(18.0%)	62.0%
母公司業主	25,716	31,536	15,965	(18.5%)	61.1%
非控制權益	240	119	54		
<b>每股盈餘(元)</b>	<b>16.19</b>	<b>19.85</b>	<b>10.07</b>		
平均匯率(美金/新台幣)	32.35	31.44	30.70		

註：數字加總不等，因四捨五入造成。

## 聯發科技股份有限公司 合併損益表 (佔營收比例)

	2024年 第二季	2024年 第一季	2023年 第二季
營業毛利率	48.8%	52.4%	47.5%
推銷費用率	(2.7%)	(2.8%)	(3.4%)
管理費用率	(2.3%)	(2.1%)	(2.4%)
研究發展費用率	(24.2%)	(23.3%)	(26.7%)
營業利益率	19.6%	24.1%	15.0%
營業外收入及支出率	3.3%	2.6%	3.7%
所得稅費用率	(2.5%)	(3.0%)	(2.4%)
本期淨利率	20.4%	23.7%	16.3%

註：數字加總不等，因四捨五入造成。

# 聯發科技股份有限公司

## 合併資產負債表

### (自結數)

(單位:新台幣佰萬元)	2024年 第二季	2024年 第一季	2023年 第二季
現金及金融資產-流動	208,674	159,767	192,428
應收帳款淨額	45,945	54,104	45,639
存貨淨額	53,578	49,212	61,067
其他流動資產	23,796	21,618	19,005
基金及投資	159,645	175,701	149,829
無形資產	82,430	80,033	81,053
其他非流動資產	107,307	106,890	111,663
資產總計	681,374	647,325	660,684
短期借款	9,080	7,820	4,450
應付帳款	32,253	39,997	29,555
其他流動負債	224,950	199,848	233,801
非流動負債合計	24,468	24,788	26,461
權益總計	390,624	374,874	366,417

註：數字加總不等，因四捨五入造成。

# 聯發科技股份有限公司 合併現金流量表 (自結數)

(單位:新台幣佰萬元)	2024年 第二季	2024年 第一季	2023年 第二季
營業活動之淨現金流入(出)	49,940	25,204	46,732
投資活動之淨現金流入(出)	(6,659)	(18,271)	(11,262)
籌資活動之淨現金流入(出)	1,045	(33,881)	(321)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,180	4,897	3,249
本期現金及約當現金增加(減少)數	46,507	(22,051)	38,398
期末現金及約當現金餘額	189,852	143,345	178,094

註：數字加總不等，因四捨五入造成。

# 補充資訊

非金管會認可之國際財務報導準則 (Non-TIFRS)  
財務資訊調節表及季度營收產品類別

## 非金管會認可之 國際財務報導準則 (Non-TIFRS) 財務資訊調節表<sup>註2</sup>

註1: 數字加總不等, 因四捨五入造成。

註2: 非金管會認可之國際財務報導準則(Non-TIFRS)為金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)之補充而非替代資訊, 調節項目為股份基礎給付獎勵、因企業合併產生之資產增值攤銷及所得稅影響數等, 其僅為補充而非替代資訊, 且最終實際盈餘分配依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)的財務數據為準。

(單位:新台幣佰萬元)

		2024年 第二季	2024年 第一季	2023年 第二季	Q-Q	Y-Y
TIFRS	營業利益	24,956	32,180	14,751	(22.4%)	69.2%
	營業利益率(%)	19.6%	24.1%	15.0%		
調節項目	股份基礎給付獎勵	245	173	561		
	因企業合併產生之資產增值攤銷	75	75	119		
Non-TIFRS	營業利益	<b>25,276</b>	<b>32,428</b>	<b>15,430</b>	(22.1%)	63.8%
	營業利益率(%)	<b>19.9%</b>	<b>24.3%</b>	<b>15.7%</b>		

TIFRS	本期淨利	25,955	31,655	16,019	(18.0%)	62.0%
	本期淨利率(%)	20.4%	23.7%	16.3%		
調節項目	本期淨利-母公司業主 每股盈餘(NT\$)	25,716 16.19	31,536 19.85	15,965 10.07	(18.5%)	61.1%
	股份基礎給付獎勵	245	173	561		
調節項目	因企業合併產生之資產增值攤銷	75	75	119		
	所得稅影響數	(44)	(34)	(94)		
Non-TIFRS	本期淨利	<b>26,231</b>	<b>31,869</b>	<b>16,605</b>	(17.7%)	58.0%
	本期淨利率(%)	<b>20.6%</b>	<b>23.9%</b>	<b>16.9%</b>		
	本期淨利-母公司業主 每股盈餘(NT\$)	<b>25,987</b> <b>16.36</b>	<b>31,745</b> <b>19.98</b>	<b>16,526</b> <b>10.42</b>	(18.1%)	57.3%

## 本季產品類別營收佔比

產品類別*	2024年 第二季 營收佔比 (註1)	QoQ%	YoY%
Mobile Phone	54%	-15%	52%
Smart Edge Platforms	40%	12%	11%
Power IC	6%	12%	9%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>-5%</b>	<b>30%</b>

註1: 百分比加總不等於100%，因四捨五入造成。

\* **Mobile Phone**: 5G/4G/3G智慧型手機、功能型手機

**Smart Edge Platforms**: 各類連網應用如路由器、寬頻網路、PON、筆記型電腦、無線藍牙耳機、智慧音箱及汽車等的無線/有線通訊晶片與單晶片；ARM架構運算單晶片及物聯網；電視；消費性/企業級客製化晶片服務

**Power IC**: 電源管理晶片

[www.mediatek.com](http://www.mediatek.com)